



Orbotech Diamond™ 10M/10MXL

最佳防焊直接成像



Orbotech Diamond 10M/10MXL

Orbotech Diamond 10M/10MXL 是高產能高階的防焊直接成像 (DI) 解決方案，適合多種防焊曝光應用。經業界驗證的 Orbotech Diamond 10M/10MXL 專為白色及其它顏色防焊設計，即使是最複雜的設計也可實現高品質成像及高產能。採用 KLA 專利的 SolderFast™ 技術，Orbotech Diamond 10M/10MXL 提升了防焊直接成像的標準，在加強了成像精確性的同時減少了整體擁有成本 (TCO)。



優勢

高品質成像

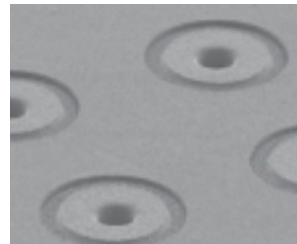
- 白色及其它顏色防焊的高品質成像
- 多波長可實現高品質側壁及優異的表面品質
- 顯著減少白色防焊的底切
- 高景深 (DOF) 適用於高低差大的表面

高產能，快速產出

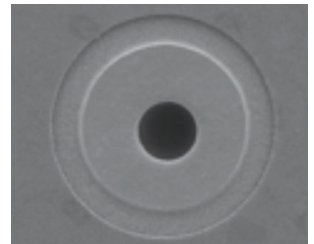
- 專利高能量照明光源
- 一次曝光成像，單次掃描即可完成全板均勻成像
- 雙檯面傳輸機製優化成像時間
- 即時靶點識別及捕捉功能

卓越的成像精度

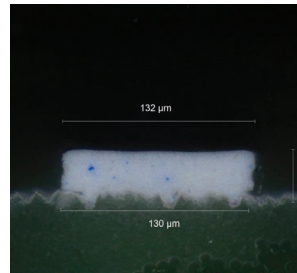
- 對位精度高達 $\pm 10\mu\text{m}$
- 高階漲縮模式和演算法，克服板材變異



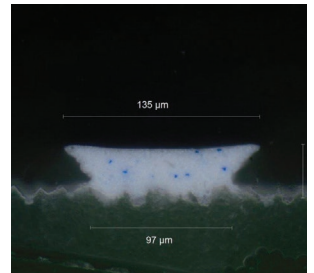
高品質防焊成像
通孔內無殘留



高對位精度



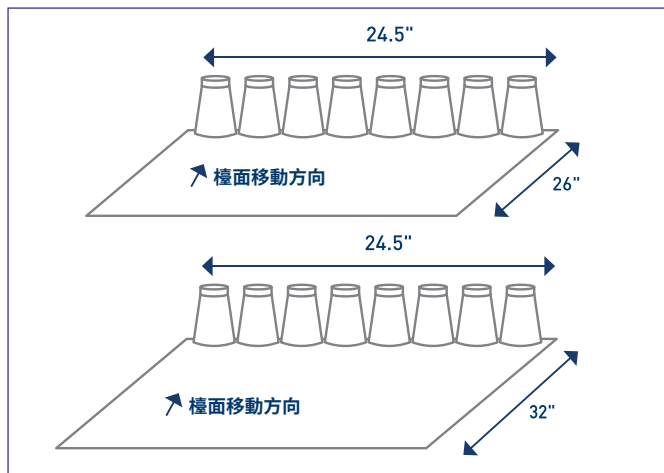
Orbotech Diamond 10M
白色防焊橋，最小底切



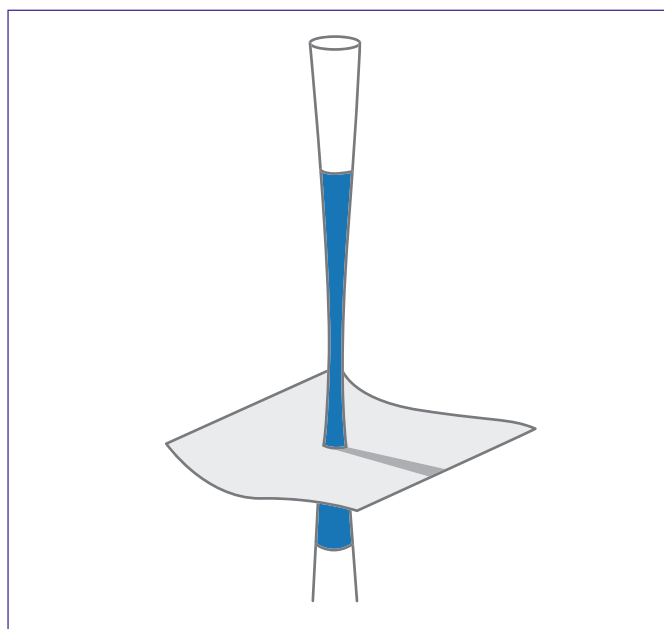
其他防焊直接成像解決方案
白色防焊橋，明顯的底切



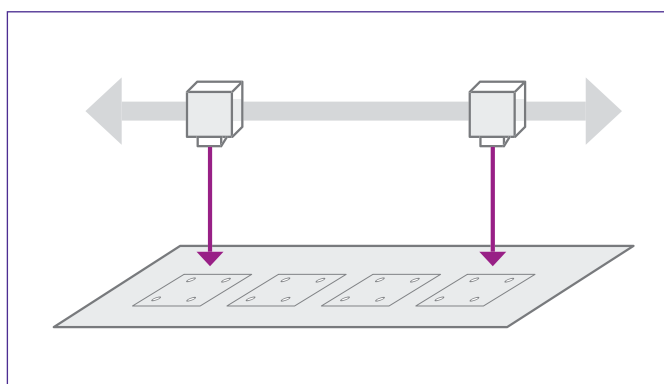
高品質成像和快速產出



一次成像實現快速產出，成像均勻且沒有拼接問題

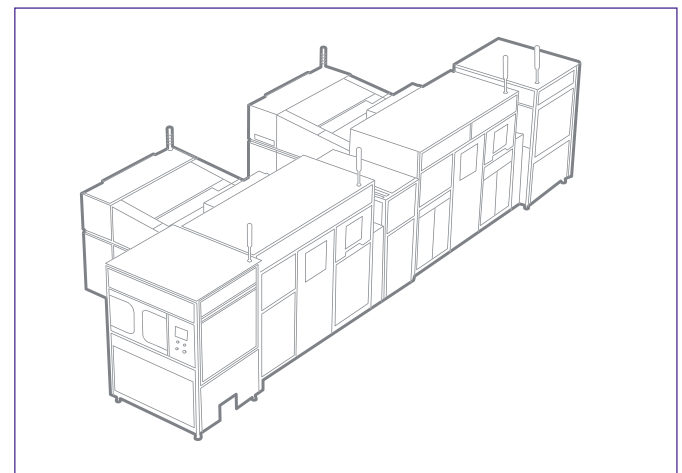


高景深 (DOF) 適用於高低差大的表面

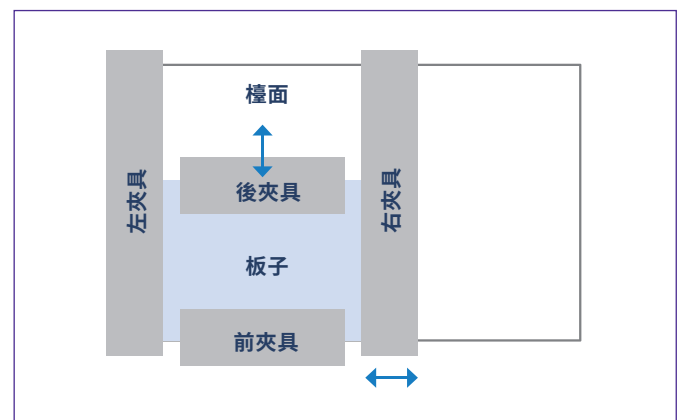


即時靶點識別及捕捉

高產能量產解決方案



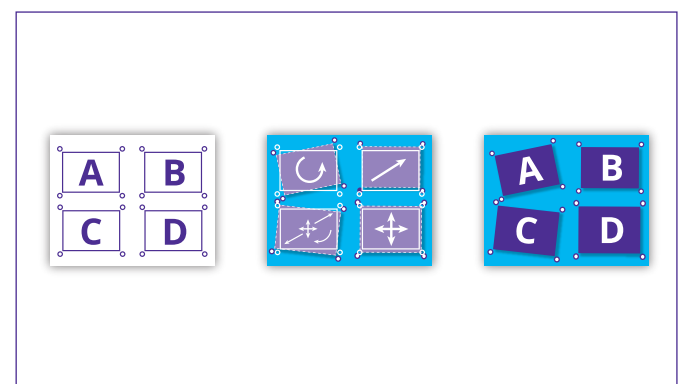
支援自動化



夾具

卓越的成像精度

高階漲縮模式和演算法可以克服具有挑戰性的板子變形，包括自動漲縮，局部漲縮及非線性漲縮



CAM 數據

板子

圖像

規格

	Orbotech Diamond 10M	Orbotech Diamond 10MXL
最小開窗*	白色防焊 - 100µm, 非白色防焊 - 75µm	
最小防焊橋*	白色防焊 - 75µm, 非白色防焊 - 50µm	
對位精度**	±10µm	
最大板子尺寸 (X/Y)	25" x 26" (635mm x 660mm)	25" x 32" (635mm x 812mm)
配備夾具時 最大板子尺寸 (X/Y)	24.5" x 23" (622mm x 584mm)	24.5" x 30" (622mm x 762mm)***
最大曝光尺寸 (X/Y)	24.5" x 26" (622mm x 660mm)	24.5" x 32" (622mm x 812mm)
配備夾具 (4邊) 時 最大曝光尺寸 (X/Y)	24" x 22.5" (609mm x 571mm)	24" x 29.5" (609mm x 749mm)
曝光能量範圍	50-2,200mj/cm ²	
尺寸	高: 1,960mm 深: 3,226mm 寬: 1,900mm	高: 1,960mm 深: 3,315mm 寬: 1,900mm
重量	5,000Kg	
夾具	選配	
應用	防焊曝光	

*取決於防焊油墨類型及製程

** 所有值均為 3σ

*** 3 邊夾具 (非 4 邊) 時尺寸為 24.5"x 32"(622mm x 812mm)

上述規格如有變更，恕不另行通知。

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、加強性能和生產率以及轉售認證工具。

© 2022 KLA Corporation 全球範圍內保留所有權利。KLA 保留無需通知而變更硬體和/或軟體規格的權利。Orbotech 是 KLA 公司 Orbotech Limited 的註冊商標。KLA 和 KLA 標識是 KLA Corporation 的註冊商標。所有品牌或產品名稱可能是各自公司的商標。

KLA Corporation
www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 4.0_5-19-2022